

USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



産業用デバイスの信頼性の高い USB データインター
フェース。多くの利点から、電気業界では USB ソケット
が最も使用されています。

USB Type-A、B、C、マイクロ USB の広範なポートフォ
リオにより、将来性のある最大 10 Gbit/s の高速デバイス
設計が可能です。USB PCB ソケットは、堅牢な規格であ
る USB 2.0、3.0、3.1 に対応しており、高速かつ簡単な
データ転送を実現します。

個々のコネクタは高い耐久性といった要件を満たし、信
頼性の高い接続技術を提供します。

- 最大 10.000 回のプラグサイクル
- THT、THR または SMD のはんだ付け工程に対応
- 180°(垂直 / 縦型) または 90°(水平 / 横型) の種別をご
利用いただけます
- ボックス (BX) またはロール (テープオンリール、RL) に
梱包
- 強化金層による防食性の向上
- 10 Gbit/s のデータ転送に対応した USB 3.1 ソケットが
高速データ転送を実現
- USB Type-C ソケットは対称的な形状のため差し込み時
の間違いがありません
- 安定したプラグ アンド プレイ操作 - システムをシャッ
トダウンまたは再起動せずに接続と切断可能

一般注文データ

バージョン	データの最小化 - USB ジャック、プリント基板用 プラグインコネクタ、USB 2.0、タイプ A, 480 Mbps, THR はんだ付け接続, 90°、プラギング回数: ≥ 1500, 極数: 4, PBT、ニッケル下地金メッキ、トレイ (手動 式アセンブリ)
注文番号	2563710000
種別	USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118572322
数量	100 items
パッケージ	トレイ (手動式アセンブリ)
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-07-30T00:00:00+02:00

USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	14 mm	奥行き (インチ)	0.5512 inch
高さ	9.74 mm	高さ (インチ)	0.3835 inch
下位バージョンの高さ	6.9 mm	幅	14.5 mm
幅 (インチ)	0.5709 inch	正味重量	2.19 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	4	LED	いいえ
ソルダーピン長 (l)	2.84 mm	PCB の取り付け	THRはんだ付け接続
ピッチ (インチ) (P)	0.079 "	シールド材質	真鍮
シールド	はい	側面終端、特性	はんだフランジ
差し込み力 / 極、最大.	35 N	転送速度	480 Mbps
極当たりソルダーピン数	1	接続方式	はんだ接続
製品ファミリー	データの最小化 - USB ジャック	ピッチ (mm) (P)	2.00 mm
保護度合い	IP20	プラギング回数	≥ 1500
外向きエルボ	90°	シールド面	ニッケルメッキ
シールドタブ	なし	性能カテゴリ	480 Mbps
はんだ付け工程	手動はんだ付け、フローは はんだ付け	引張強度 / 極、最大.	10.00 N
はんだピン寸法	八角形	はんだピン位置の公差	0.1 mm

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点	500 V AC	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
公称電圧	30 V	定格電流	250 V ACで 1.5 A

材料データ

絶縁材	PBT	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II
比較追跡指数 (CTI)	≥ 500	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
保管温度、最小	-20 °C	保管温度、最大	60 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

梱包

パッケージ	トレイ (手動式アセンブリ)	VPE 長	250.00 mm
VPE幅	199.00 mm	VPEの高さ	19.00 mm

USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

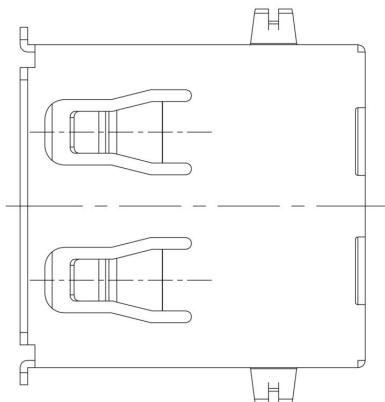
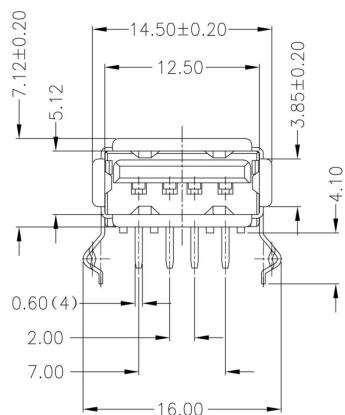
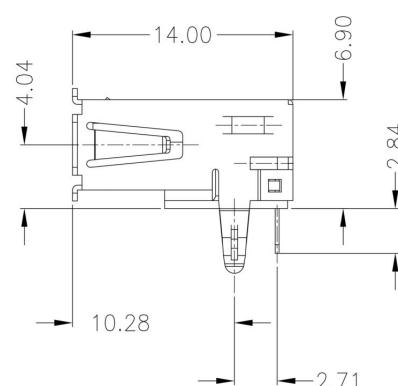
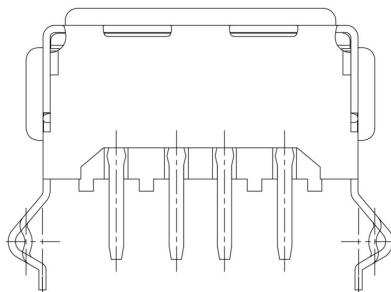
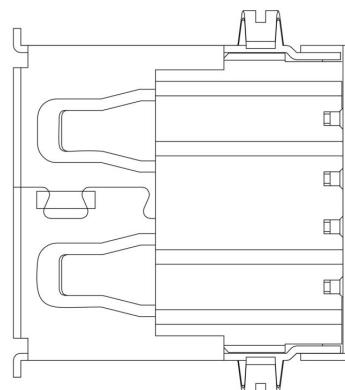
重要なメモ**注意事項****分類**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

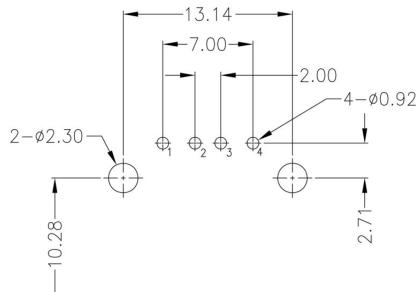
www.weidmueller.com

図面**寸法図****寸法図****寸法図****寸法図****寸法図**

USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面**PCB設計****凡例**

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL
Colour / Special Option										
	BL	blue (plastic)								
	BK	black (plastic)								
	WH	white (plastic)								
	SO	customized product								
Packaging										
	TY	Tray in box (manual assembly)								
	RL	Tape on Reel (automated assembly)								
	TU	Tube								
Contact surface thickness										
	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"								
	N	no use								
Solder Pin length										
	3.2	3.2 mm								
	1.6	1.6 mm								
	D	SMD								
Direction										
	H	Horizontal (90°, side entry)								
	U	Horizontal, Upright 90°								
	V	Vertical (180°, top entry)								
Number of Ports										
	1	1 Port								
	21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel								
Assembly on PCB										
	R	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering								
	S	Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering								
	T	Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave								
Type / Performance										
	2.0A	USB 2.0 Type A								
	3.0A	USB 3.0 Type A								